



2025年4月期 第2四半期決算説明会資料



JQA-QMA16212



MS
CM009

2024年12月18日
インスペック株式会社

Copyright 2024 inspec All Rights Reserved



(証券コード：6656)

**第 1 部 2025年4月期
第 2 四半期決算概況**

第 2 部 今後の成長戦略



第 1 部 2025年4月期 第 2 四半期決算概況

第 2 部 今後の成長戦略

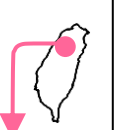
超ハイエンドの精密電子部品外観検査で、グローバルニッチトップ

商号	インスペック株式会社
本社	秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79-1
創業	1984年（昭和59年）1月
上場市場	東京証券取引所スタンダード市場
代表者	代表取締役社長 菅原 雅史
主な事業	電子回路基板（半導体パッケージ基板・FPC等）の外観検査装置及び製造装置の開発・製造・販売・サービス
従業員	84名
資本金	810百万円
発行済株式数	4,006,800株（単元株数：100株）
株主数	4,176名

インスペック本社
秋田県仙北市角館町



非連結子会社
Inspec TAIWAN
台湾桃園県
中国・タイ・ベトナムに
サポート体制有り



東京オフィス
東京都港区浜松町

長野サポートセンター
長野県長野市



春



夏



秋



冬



角館の四季

期末の注残及び期初の受注を堅調にこなし、主力製品であるロールtoロール型検査装置、高性能フラットベッド型検査装置の受注を国内外の顧客から安定的に獲得

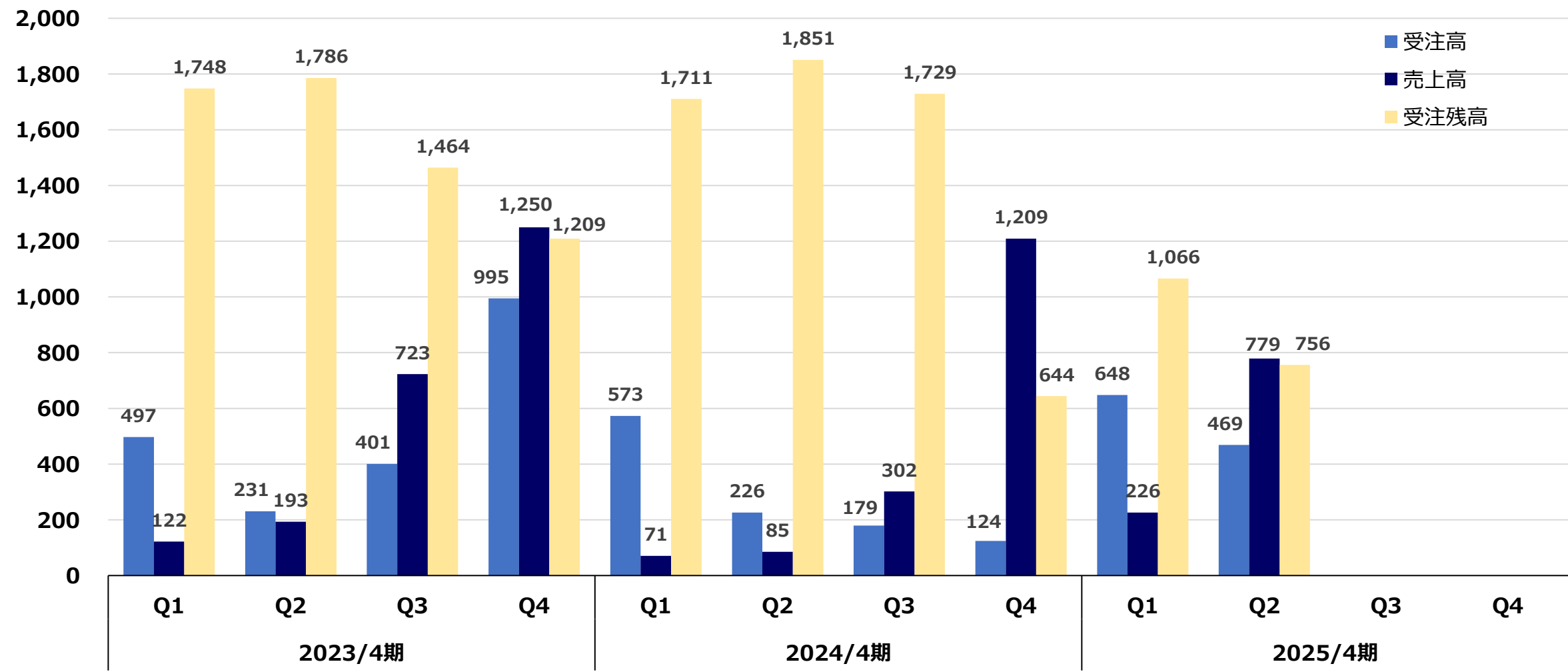
(単位：百万円)

	2025年4月期 第2四半期	2024年4月期 第2四半期	前期比	増減率
売上高	1,005	156	849	541.0%
営業利益	1	△340	341	－
経常利益	13	△354	367	－
当期純利益	10	△363	373	－

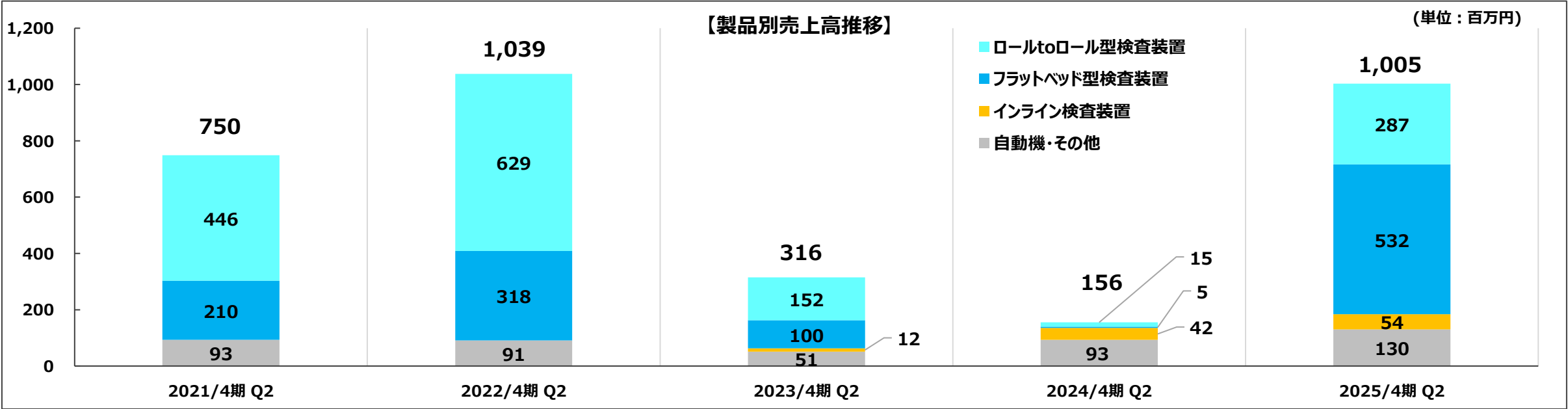
四半期毎の推移

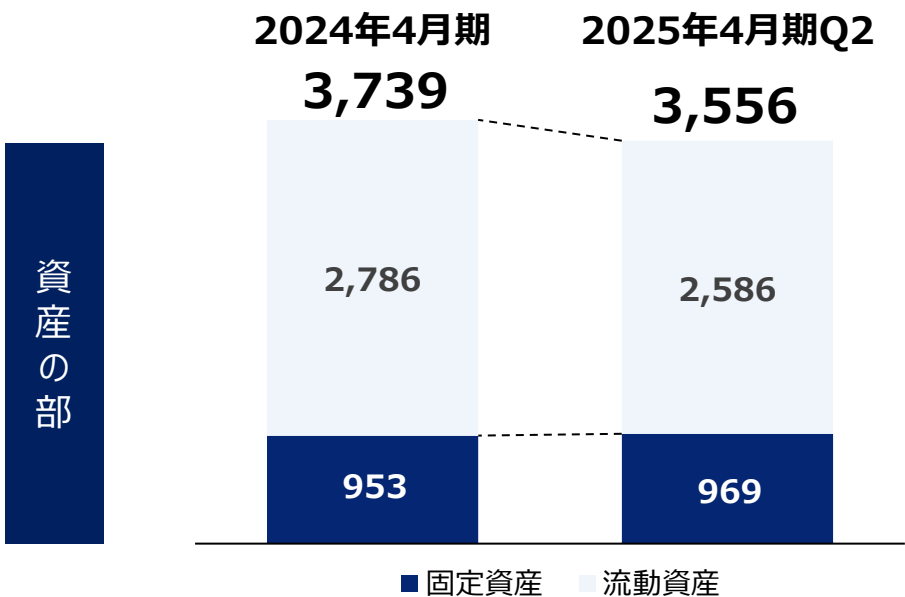
(単位：百万円)

Q2受注残高
：756百万円



	2025年4月期Q2		2024年4月期Q2		前年同期比 増減率
	金額（百万円）	構成比	金額（百万円）	構成比	
売上高合計	1,005	100.0%	156	100.0%	541.0%
■ ロールtoロール型検査装置	287	28.6%	15	10.0%	1,813.3%
■ フラットベッド型検査装置	532	53.0%	5	3.8%	10,540.0%
■ インライン検査装置	54	5.4%	42	26.8%	28.6%
■ 自動機・その他	130	13.0%	93	59.4%	39.8%

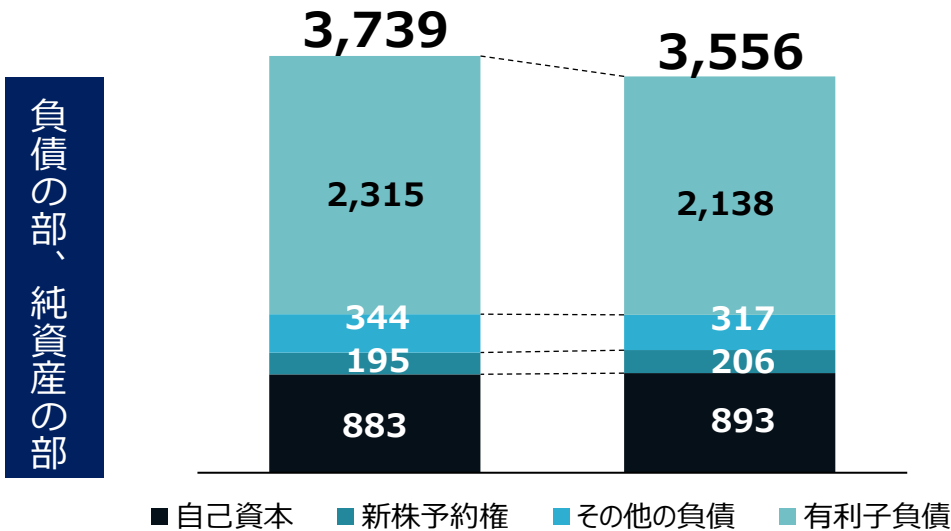




	2024年4月期	2025年4月期Q2
自己資本	883百万円	893百万円
自己資本比率	23.6%	25.1%

【主な増減要因】

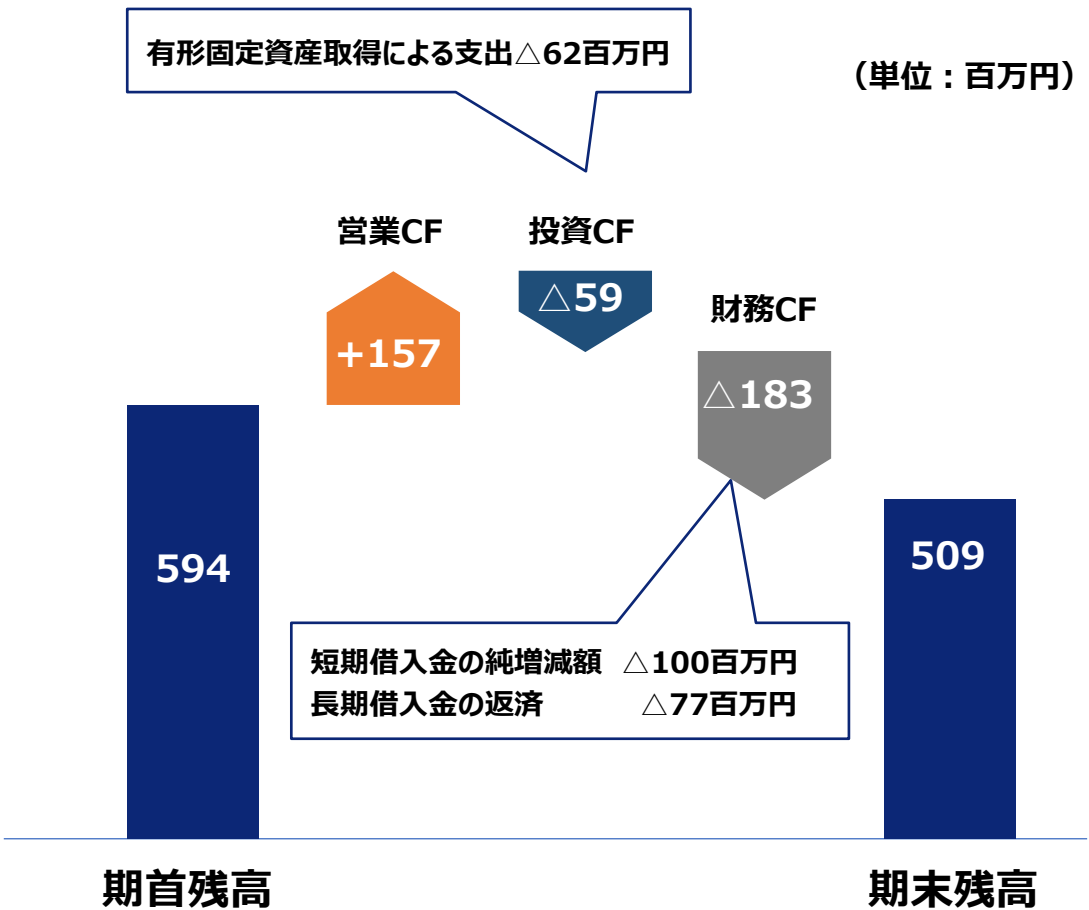
電子記録債権：84百万円増加
仕掛品：154百万円減少



短期借入金：100百万円減少
長期借入金：77百万円減少

中間純利益の計上：10百万円

現金及び現金同等物 84百万円の減少



(単位：百万円)

	2024年4月期 Q2	2025年4月期 Q2
期首現金及び 現金同等物残高	437	594
営業活動による キャッシュ・フロー	96	157
投資活動による キャッシュ・フロー	△15	△59
フリー キャッシュ・フロー	81	98
財務活動による キャッシュ・フロー	△86	△183
現金及び現金同等 に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物 の増減額（減少△）	△4	△84
期末現金及び 現金同等物残高	432	509

	2025年4月期Q2		2024年4月期Q2		対前年 増減率
	金額（百万円）	対売上比	金額（百万円）	対売上比	
基板検査装置事業	128	12.8%	101	64.7%	26.7%
露光装置事業	71	N/A	108	N/A	△34.3%
合 計	200	19.9%	209	133.7%	△4.4%

- 基板検査装置事業（半導体パッケージ基板検査装置・FPC検査装置）
 - ・次世代及び次々世代の半導体パッケージ基板向けのウルトラファインAOIの開発
 - ・リペア装置（AOS：光学式自動シェイピング装置）の開発及び次世代リペア装置の開発（Go-Tech事業）
- 露光装置事業（ロールtoロール型直描露光装置）
 - ・エレクトロニクス市場向け高性能露光装置の開発

- ・生成AI向け半導体を中心とした市場の拡大により検査装置需要増加の見込み
- ・通期見通し達成に向けて、堅調に受注額を積み上げ

(単位：百万円)

	公表値	前期実績	増減	増減率
売上高	2,350	1,668	682	40.9%
営業利益	100	△233	333	—
経常利益	100	△263	363	—
当期純利益	80	△353	433	—

第 1 部 2025年4月期
第 2 四半期決算概況

第 2 部 今後の成長戦略

Mission 変化を先取りし、革新的な製品を生み出す

Vision 既存事業と新事業による成長の持続と稼ぐ力の向上で企業価値の拡大を図る

2025年4月期～2027年4月期

2028年4月期～2030年4月期

基板検査装置事業

- ・進化が加速する微細化・高機能化への対応
- ・EVを主力としたFPC検査市場へ注力

露光装置事業

- ・車載FPC用シェア拡大
- ・両面同時露光・長尺の強みを生かした販促強化
- ・ハイエンドクラスのスマートフォン市場向けへ進化

新規事業

- ・M&Aを視野に将来性のある第三の柱を検討

- ・台湾、東南アジアへの販促強化

Vision 2030 GOAL

売上高 100億円

営業利益 20億円

成長

売上高成長率 30%以上

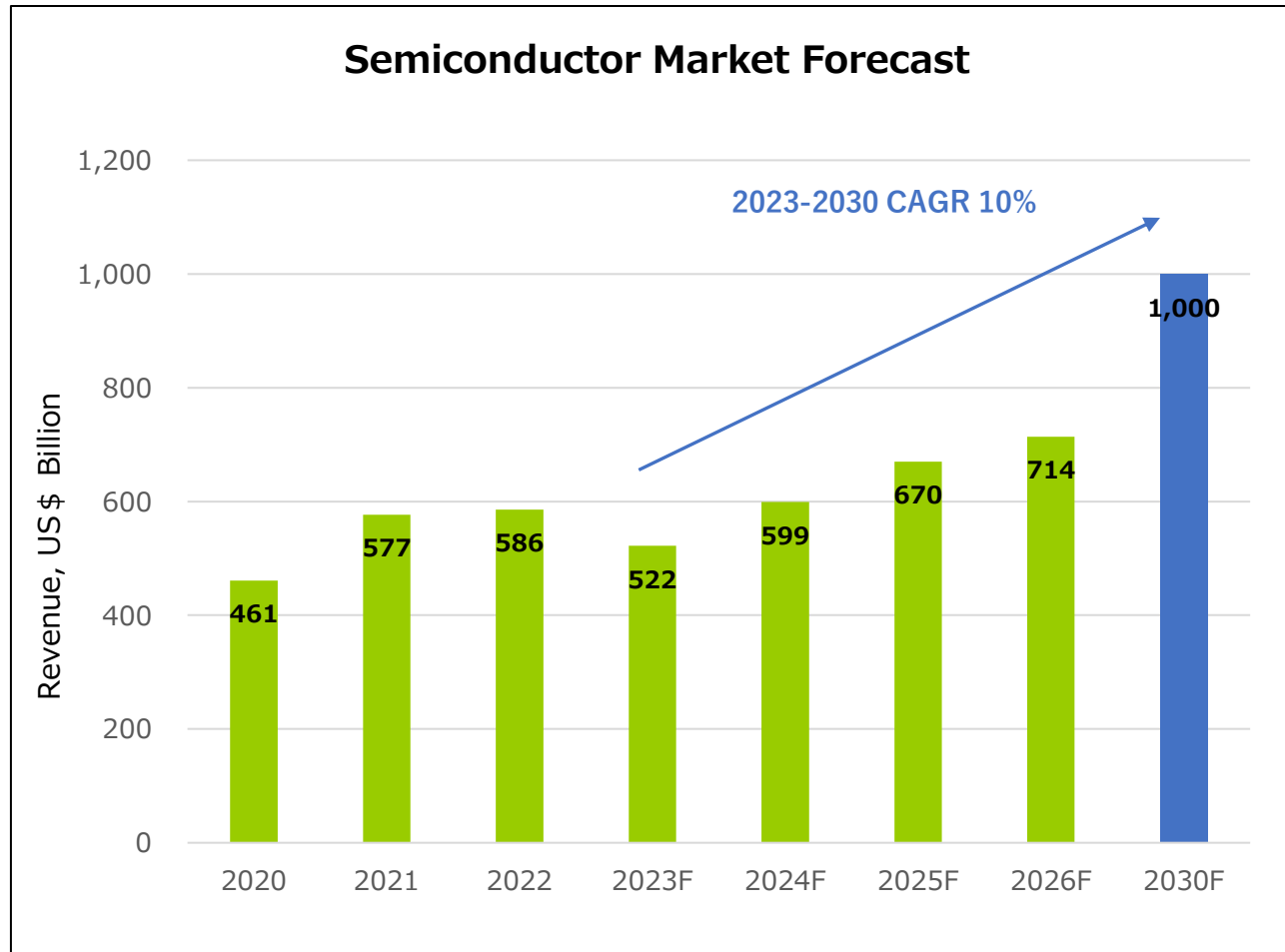
営業利益率 20%以上

稼ぐ力

ROIC 10%以上

ROE 20%以上

半導体世界市場はAI/車載用途がけん引し、成長継続



出所：SEMIジャパン資料を基に当社作成

◆半導体立国への国を挙げてのチャレンジ

◆半導体パッケージ基板の重要性が高まり投資が加速

◆生成AIの急成長で、データセンターの拡大継続



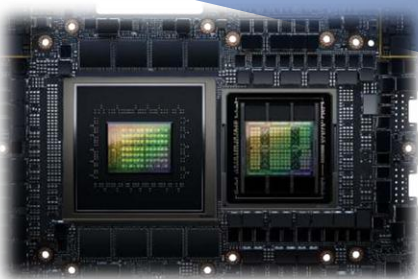
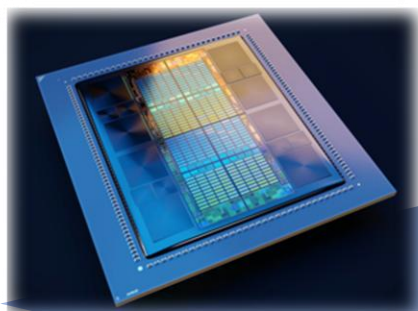
【基板検査装置事業】

AIサーバーやクラウドコンピューティングの普及を背景に、次世代CPU・GPUなどのハイエンドデバイスにおけるチップレット化で、より高機能化するパッケージングの需要が益々高まっていく

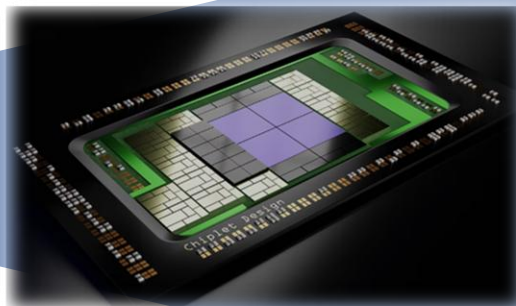
【露光装置事業】

グローバルに成長するEV市場の拡大により微細化するFPCの需要が益々高まっていく

生成AIの加速度的進化に伴い、高性能半導体の市場拡大



NVIDIA GH200 Grace Hopper
(出所：NVIDIA)



チップレット
(出所：東京エレクトロン)



次世代最先端検査システムの開発が進行中

次世代CPU・GPUなどのハイエンドデバイスにおけるチップレット化で、より高機能化する半導体パッケージングへ対応する検査装置を開発

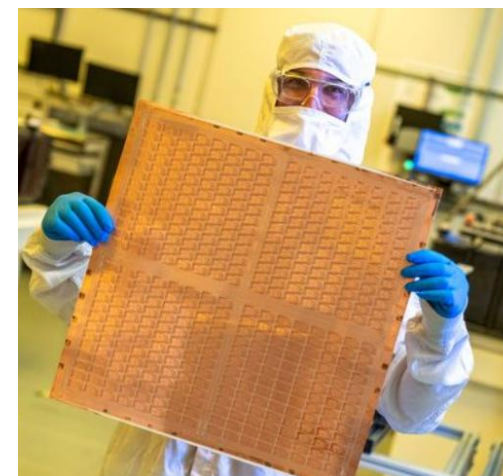
自動運転、データセンター、ロボティクス、生成AIが作り出す未来に SX7000シリーズが貢献



Line/Space	装置	リリース時期
2/2	SX7300	2024年
1.5/1.5	SX7400	2024年
1.0/1.0	SX7500	2025年予定

- L/S=1/1 μ mへの対応
- ガラス基板への応用
- 半導体パッケージ基板大型化への対応
- 全自動化システムの更なる進化

次世代トレンド



ガラス基板
(出所：インテル)

**半導体パッケージ基板は
有機基板からガラス基板へ**

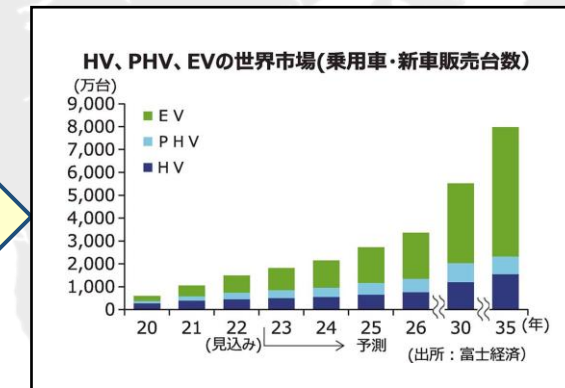
2025年4月期

2026年4月期

2027年4月期

グローバルに成長するEV市場に向け、車載FPC用露光装置のシェアを拡大し、微細化・スループット向上の対応により、多種多様なFPC市場へ進出

EV市場の拡大により車載FPCの需要増



航空宇宙産業、医療等、新たなFPC市場へ

国内直販/中国代理店

東南アジア/北米/欧州へ展開



ロールtoロール型シームレス
両面同時直描露光装置
『RD3000FB』

L/S=50/50 μ m

微細化への対応 L/S=30/30 μ m

多波長光源開発によるスループット向上

海外拠点強化、タイ・ベトナム地域での販売展開



海外拠点の強化

半導体強国にある台湾の事務所を移転し、本社役員を常駐、新たな販売網を構築

タイ・ベトナム地域での販売展開

代理店香港WWGと連携し、半導体関連産業の集積が進むタイ・ベトナム地域での販売活動を開始

国内外で積極的にPR活動を展開

12月 HKPCA Show 国際電子回路(深圳)展覧会 (中国・深圳)
7月 THECA2024 (タイ)
6月 JPCA Show 2024 (日本)
5月 CPCA Show 2024 (中国・上海)
2月 インテリジェント アジア タイランド 2024 (タイ)
1月 インターネプコン ジャパン (日本)



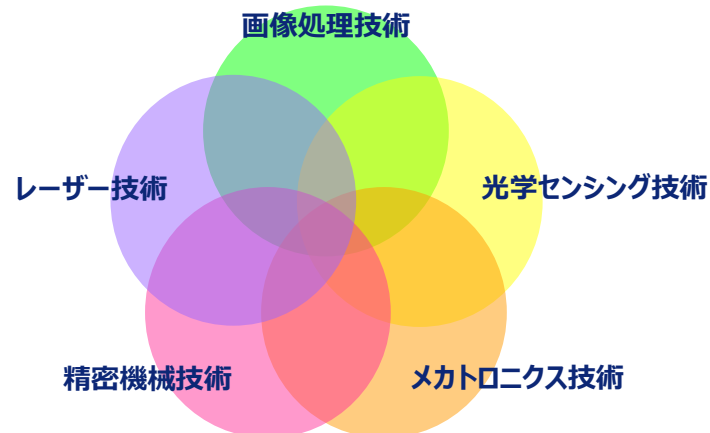


Appendix

確かな技術とあくなき挑戦で、創造社会を切り拓く

社員が幸せになれる会社、そしてその先の誰もが輝き心豊かに生きることが出来る社会を目指して

確かな技術



あくなき挑戦

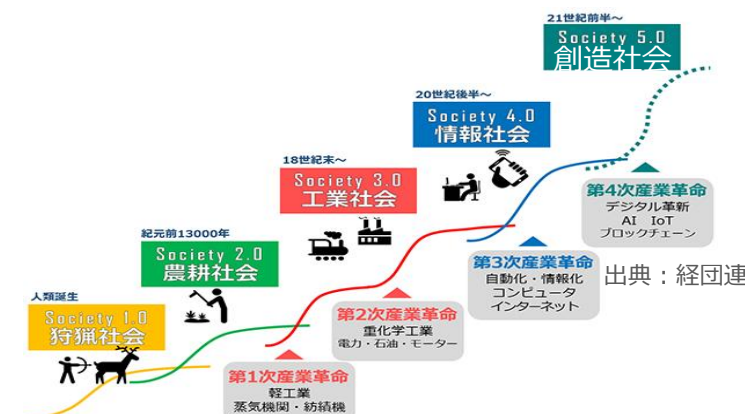


当社の成長を牽引した製品たち



世には出ることにはなかったが、現在の事業の礎となった製品たち

創造社会



創造社会とは、「誰もが輝き心豊かに生きることが出来る社会」とあります。

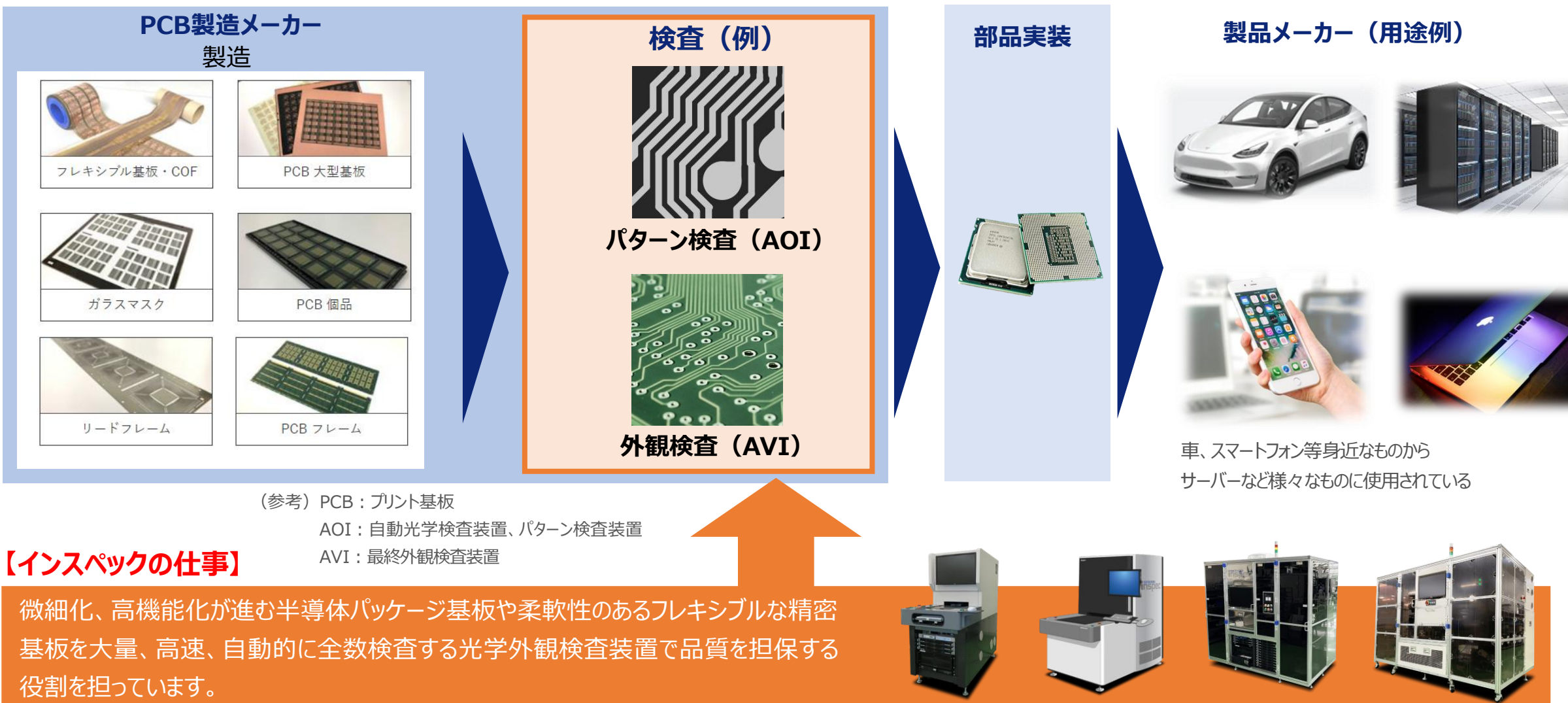
創造社会の実現に貢献するためには、何よりも第一にインスペックの社員が幸せにならなければなりません。

「社員が幸せになれる会社」への取り組みこそが創造社会の実現への取り組みであり、まさにそのことがインスペックの存在意義です。

切り拓く

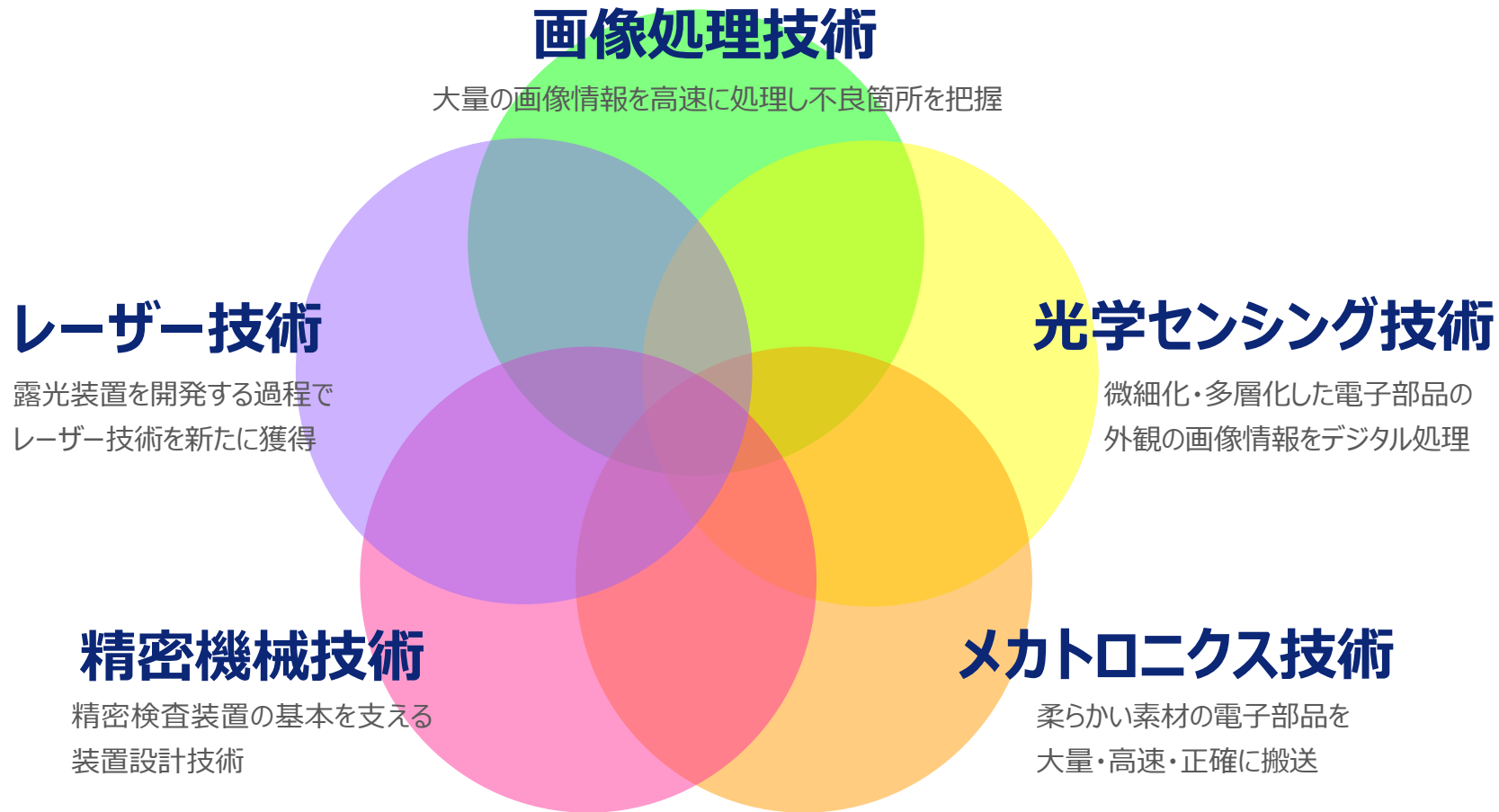
インスペックは自社が持つ技術・ノウハウを駆使して、まだ見ぬ明日へチャレンジし続けます。

最先端PCBの品質を担保する役割を担う



インスペックの地位を支える5つの要素技術

外観検査に必要とされる技術要素のすべてを社内に保有。長年の経験とデータ蓄積に基づき最適化し、総合力でベストソリューションを提供



フラットベッド型検査装置

次世代半導体向けのフラットベッドタイプの精密基板検査装置

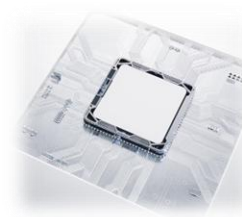


半導体パッケージ基板向け
AOI検査装置『**SX5600**』
最先端（L/S=2/2μm）の
超高精細基板に対応

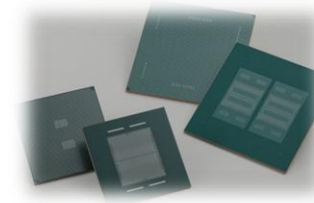


多用途コンパクトAOI検査装置『**SX1000**』
省スペース、低コストなエントリーモデル、精密
穴（レーザービア）検査で多くの実績

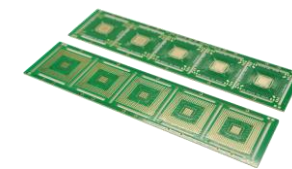
検査対象製品例



ガラス基板
（出所：東京エレクトロン株式会社）



半導体パッケージ基板
（出所：日経クロステック）



半導体パッケージ基板
（出所：エムエス電子株式会社）

【市場環境キーワード】

次世代データセンター、高性能CPU、電子部品の急増

微細化・高機能化が進む超ハイエンドの最先端
ファインパターン検査に対応

ロールtoロール型検査装置

FPC基板や液晶向けのCOF向け等の柔軟な基盤をベースにした電子デバイス検査装置



ものづくり日本大賞
経済産業大臣賞



エレクトロニクス分野向け

ロールtoロール型AOI検査装置『RA7100』

FPC基板のファインピッチパターン向け検査装置、
業界最速クラスの検査速度を誇り、圧倒的な競争力で多数の実績あり

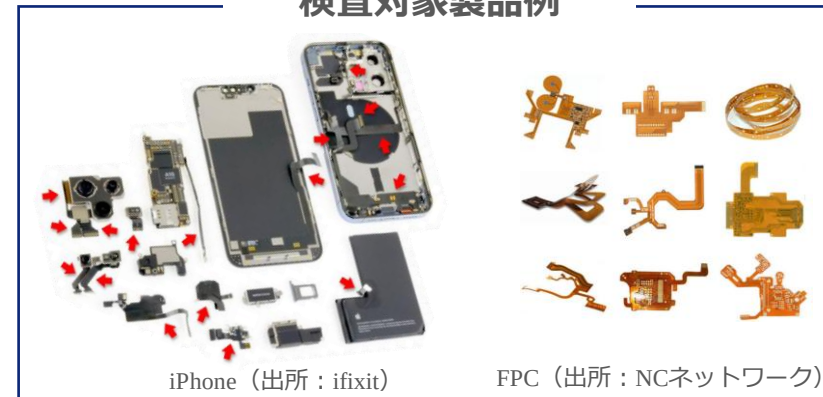


車載分野向け

ロールtoロール型FPC検査装置『RA7400』

ノンストップで高スループットと長尺対応を実現、
ベリファイレスをサポートする自動分類機能搭載

検査対象製品例



【市場環境キーワード】

生成AIスマートフォン市場の拡大、EVシフト

ロール状での高精度高速自動外観
検査ニーズの需要増に対応

当社は、パーパス「確かな技術とあくなき挑戦で、創造社会を切り拓く」を通じて、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指します。

活力ある職場づくり

交流・能力開発・仕事と生活の調和によって働きがいのある職場づくり



- 支援学校実習受け入れ
- インターンシップ受け入れ



- 女性社員の雇用・活躍の推進
- 出産・育児・介護休暇の取得推進



- 有給休暇取得推進
- 外部研修の実施



女性マネジメント塾



角館武家屋敷清掃活動

社会貢献活動

地域社会をはじめとした社会貢献活動を推進



- 開発途上国にワクチン提供支援（ペットボトルキャップ・古着回収）
- 社内献血活動



- 角館武家屋敷清掃活動
- 地元災害ボランティアへの登録



- フードロス対策自販機の社内設置
- 社内空調にガスエアコンを使用
- 照明のLEDライト化



献血活動



ペットボトルキャップ回収活動

技術開発

検査装置・露光装置の開発を通じて技術革新に貢献



- 検査装置・露光装置による生産性向上への貢献
- 欠陥自動分類技術による人手不足解消への貢献
- 電気自動車等のクリーンエネルギー技術発展への貢献



プロバスケットボールチームオフィシャルスポンサー



半導体パッケージ基板向けAOI『SX5600』

- インспек基板AOIのフラッグシップモデル
- 最先端の超高精細基板に対応
- クラス最速レベルの生産性を実現



ロールtoロール型FPC検査装置『RA7400』

- ノンストップで高スループットと長尺対応の実現
- ベリファイレスをサポートする自動分類機能搭載
- コンパクトな外形



ロールtoロール型シームレス 両面同時直描露光装置『RD3000FB』

- 世界初の両面同時長尺シームレス露光を実現
- 両面同時露光で生産性が2倍
- クラス最小レベルの設置面積

本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としたものではありません。
本資料を作成するに当たっては、正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。
本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。
本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及又は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることをご承知おきください。